证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-036

气派科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

二〇二五年八月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。

三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票事宜已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行尚需经公司股东会审议通过，尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

二、本次向特定对象发行股票的发行对象为梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生，梁大钟先生、白瑛女士系本公司实际控制人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士的儿子。梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生为本公司的关联方，本次发行构成关联交易。

在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事专门会议发表了同意的审查意见，关联董事已回避表决。

三、本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日。发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将做出相应调整。

四、本次发行股票数量不超过7,900,000股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。

五、若本次发行前，实际控制人梁大钟、白瑛控制的公司股份比例不低于50%(含本数)，则梁大钟、白瑛、梁华特认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；若本次发行前实际控制人梁大钟、白瑛控制的公司股份比例低于50%，则梁大钟、白瑛、梁华特认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若梁大钟、白瑛、梁华特所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所的最新监管规定不一致的，按照中国证监会、上交所的规定执行，梁大钟、白瑛、梁华特应根据监管规定相应调整锁定承诺。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期满后，发行对象减持其所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

六、本次发行拟募集资金总额不超过15,900.00万元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

七、公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

八、本次发行前，公司控股股东为梁大钟，实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇。本次发行完成后，梁大钟先生仍系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士仍系公司实际控制人，梁华特将成为公司的实际控制人之一。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不涉及重大资产重组。

九、为完善和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，根据回报投资者，公司积极落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《气派科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。关于公司利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案"第七节 利润分配政策及执行情况"。

十、根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024]10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)要求，为保障中小投资者利益，公司制定了本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人及其关联方梁华特、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺事项等议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。

本次发行后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺请参见本预案"第八节 本次发行股票摊薄即期回报分析"。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

十一、本次向特定对象发行A股股票方案尚需获得公司股东会的批准并经上交所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准或注册，以及最终获得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

十二、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案"第六节 本次股票发行相关的风险说明"的有关内容，注意相关风险。

释 义

本发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、气派科技	指	气派科技股份有限公司
本次发行	指	气派科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的行为
广东气派	指	广东气派科技有限公司
气派芯竞	指	气派芯竞科技有限公司
气派渠远	指	东莞市气派渠远股权投资合伙企业(有限合伙)
惠州气派	指	惠州气派科技有限公司
股东会	指	气派科技股份有限公司股东会
董事会	指	气派科技股份有限公司董事会
审计委员会	指	气派科技股份有限公司董事会审计委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所创板股票上市规则》
报告期	指	2022年、2023年、2024年及2025年1-6月
报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年6月30日
预案、本预案	指	气派科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
集成电路/芯片/IC	指	按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体(如硅、锗等)晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构
功率半导体	指	支持高电压、大电流转换的半导体器件，可完成电子装置中电压和频率、直流交流的转换
晶圆	指	又称Wafer，圆片，指硅材质的且在上面重复排布具有完整电性能的集成电路或者晶体管的晶圆，尺寸有4吋、5吋、6吋、8吋、12吋等
封装	指	对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响(包括物理、化学的影响)，起到保护芯片、增强导热(散热)性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以连接芯片内部与外部电路的作用
CPC	指	一种由气派科技自主定义的表面贴片式封装形式
SOP	指	Small Outline Package的缩写，小外形封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形)
SOT	指	Small Outline Transistor的缩写，小外形晶体管贴片封装，随着集成电路集成度的提高，现在多用于封装集成电路，是表面贴装型封装之一，一般引脚小于等于8个的小外形晶体管、集成电路
LQFP	指	Low-profile Quad Flat Package的缩写，薄型四边引线扁平封装，塑封体厚度为1.4mm
QFN	指	Quad Flat No-lead Package的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比QFP小、高度比QFP低
DFN	指	Dual Flat No-lead Package的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN的设计初应用与QFN类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN和QFN的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周
Qipai	指	由气派科技自主定义的双排直插式的封装形式
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems的缩写，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源、微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统
FC	指	FC是Flip Chip的缩写，倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
QFN	指	Quad Flat No-lead Package的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比QFP小、高度比QFP低
DFN	指	Dual Flat No-lead Package的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN的设计初应用与QFN类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN和QFN的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周
TO	指	Transistor Out-line Package的缩写，即晶体管外形封装，是一种直插式的封装形式
DIP	指	Dual in line-pin Package的缩写，也叫双列直插式封装技术，采用双列直插形式封装的集成电路
CPC	指	由气派科技自主定义的表面贴片式封装形式
CDFN/CQFN	指	由气派科技自主创新且定义的封装系列，区别SOP和QFN/DFN，在保证散热的情况下，既能使用回流焊焊接，也可以波峰焊焊接，是小体积的贴片式系列封装形式
PDFN	指	Passive-Down-Flux-on-Noodle,紧凑型表面贴装器件封装，采用塑封封装材料，无引脚设计，具有两面金属连接区域，适用于高密度集成电路
氮化镓/GaN	指	Gallium Nitride,氮和镓的化合物，一种第三代半导体材料，具有高击穿电压、高电流密度、电子饱和飘移速度高等特点，主要应用在5G通讯、半导体显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	气派科技股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

第一节 本次发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	气派科技股份有限公司
英文名称	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
法定代表人	梁大钟
有限公司成立日期	2006年11月7日
股份公司成立日期	2013年6月6日
注册资本	106,879,805元
统一社会信用代码	91440300795419672 2
电话	0769-89886666
传真	0769-89886013
电子信箱	IR.@chippacking.com
邮政编码	523330
公司网址	www.chippacking.com
上市日期	2021年6月23日
股票上市地	上海证券交易所创板
公司股票简称	气派科技
股票代码	688216
经营范围	一般经营项目是:集成电路的研发、测试封装、设计、销售(不含蚀刻等有工业废水产生的工艺及其他限制项目)，货物进出口、技术进出口;设备租赁(不含融资租赁)!法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

二、本次发行的背景和目的

(一)本次发行的背景

1.国家行业规划及产业政策的大力支持

半导体产业是电子信息产业的基础和核心，是科技创新的先驱，在世界经济发展中占据越来越重要的地位。在新一轮科技和产业革命的背景下，云计算、大数据、5G、人工智能、工业互联网、智能网联汽车、新能源汽车等新需求、新应用不断涌现。无论这些新兴领域如何发展演变，都离不开半导体的支撑保障，并将进一步扩大对半导体的应用需求。

2021年3月，第十三届全国人大第四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。2022年12月，国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》提出:社大战略性新兴产业，深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。为贯彻国家半导体产业发展战略部署，抢抓半导体产业发展重大机遇，广东省政府先后制定一系列鼓励与支持的产业政策。2021年7月广东省政府印发《广东省制造业高质量发展"十四五"规划》提出:以广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、江门等市为依托，重点发展5G器件、5G网络与基站设备、5G天线以及终端配件等优势产业，补齐补强第三代半导体、滤波器、功率放大器等基础材料与核心零部件产业，打造万亿级5G产业集群。

2.半导体封装测试行业拥有广阔的市场前景

半导体封装测试行业是整个半导体产业链中的关键环节，随着5G通信、物联网(IoT)、人工智能(AI)、自动驾驶汽车等新兴技术的发展，对高性能、低功耗、高可靠性的芯片需求增加，推动了封装测试市场的增长，先进封装技术如3D封装、系统级封装(SiP)、晶圆级封装(WLP)等正在逐渐增长，Yole预测先进封装市场规模将从2024年的450亿美元增长至2030年的800亿美元，年复合增长率达9.4%。业内领先封测企业通过加速布局3D封装、Chiplet技术持续保持竞争力，从技术层面，异构集成(如混合键合、扇出型封装)和Chiplet技术成为突破摩尔定律的核心路径，碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等第三代半导体的封装技术成为功率半导体不可或缺的技术。

根据中国半导体行业协会统计，2023年全球封测市场规模为822亿美元，同比增长0.86%。未来，全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好，预计2026年市场规模有望达961亿美元。根据中国半导体行业协会统计，中国市场2023年封装测试业销售额2,932.2亿元，市场空间广阔，为封测企业的长期可持续发展提供了有利条件。

3.半导体行业景气度逐步复苏

半导体行业呈现"强周期性"，每3-5年经历一轮"需求爆发-产能扩张-库存调整-复苏"的循环，2020-2021年全球半导体行业需求激增，供应链短缺导致芯片价格暴涨，行业资本开支大幅增加；2022年全球经济放缓、终端消费电子需求疲软，行业进入库存调整期，部分领域价格回落。

2023年第四季度起，随着半导体行业AI算力芯片、汽车电子、消费电子需求韧性凸显，叠加库存去化接近尾声，半导体行业呈现温和复苏态势。

市场调查机构Gartner的最新数据显示，2024年全球半导体收入总计6,559亿美元，较2023年的5,421亿美元增长21%。据Wind统计，2024年，国内162家半导体上市公司实现营业收入6,022.25亿元，对比2023年4,972.81亿元增长21.1%；实现归母净利润353.41亿元，对比2023年的313.18亿元增长12.85%。行业整体保持了双位数增长的良好态势。

4.本次发行符合公司发展战略

公司一直致力于半导体封装测试相关技术的研发创新并不断加强研发投入，掌握了多项核心技术。公司将根据行业未来发展趋势及技术发展方向，加强对新兴领域的研发投入，持续对功率半导体和先进封装方面投入研发，开发更多品类功率半导体封装和先进封装技术，为公司产品丰富提供有力的技术支撑。

本次发行股票有利于公司改善资产负债结构，为公司扩大经营提供了更充足的资金保障，从而有助于抓住市场机遇，在满足市场需求快速增长的同时，提升上市公司盈利能力。通过本次发行，公司将进一步增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构，增强偿债能力，降低财务风险，增强其稳健经营能力，提升上市公司竞争实力，实现可持续发展。

(二)本次发行的目的

1.实际控制人及其关联方增持，展示对公司未来发展的坚定信心

公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特全额认购公司本次向特定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。

2.有利于公司的可持续发展，实现战略目标

公司所处的半导体封装测试行业为资金密集型和技术密集型行业，生产经营、研发投入较大，银行借款等有息负债金额较高，资产负债率处于较高水平，仅仅通过自身经营积累难以满足公司业务拓展对运营资金的需求。通过股权融资补充流动资金，有利于优化公司财务结构，防范经营风险，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境。

三、发行对象及其与公司的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，梁大钟为公司控股股东、实际控制人，白瑛为公司实际控制人，梁华特系梁大钟、白瑛的儿子，本次发行完成后，梁华特将成为公司的实际控制人之一。

四、本次发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

(三)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，梁大钟为公司控股股东、实际控制人，白瑛为公司实际控制人，梁华特系梁大钟、白瑛的儿子。三人将以现金方式全额认购本次发行的股票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议关于本次发行股票的董事会决议公告日(即第五届董事会第三次会议决议公告日:2025年8月15日)。

本次发行的发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

(五)发行数量

本次发行股票数量不超过7,900,000股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整，调整公式为：

Q1=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的本次发行股票数量;n为每股的送股、资本公积转增股本的比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量);Q1为调整后的本次发行股票数量。

(六)限售期安排

若本次发行前，实际控制人梁大钟、白瑛控制的公司股份比例不低于50%(含本数)，则梁大钟、白瑛、梁华特认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；若本次发行前，实际控制人梁大钟、白瑛控制的公司股份比例低于50%，则梁大钟、白瑛、梁华特认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

若梁大钟、白瑛、梁华特所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所的最新监管规定不一致的，按照中国证监会、上交所的规定执行，梁大钟、白瑛、梁华特应根据监管规定相应调整锁定承诺。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期满后，发行对象减持其所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

(七)募集资金规模及用途

本次发行拟募集资金总额不超过15,900.00万元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。

(九)本次发行前滚存未分配利润安排

公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(十)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行完成前，梁大钟先生系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士系公司实际控制人；本次发行完成后，梁大钟先生仍系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士仍系公司实际控制人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士的儿子，梁华特将成为公司实际控制人之一。梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生为本公司的关联方，梁大钟、白瑛、梁华特拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

公司审计委员会发表了同意的书面审核意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。股东会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联股东应进行回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司股本总额为10,687.98万股，梁大钟直接持有公司4,579.00万股股份，通过气派渠远间接控制公司1.50万股，合计控制公司股份总数的42.86%，系公司的控股股东；白瑛直接持有公司1,080.00万股，占公司股份总数的10.11%，梁大钟、白瑛夫妇合计控制公司股份总数的52.96%，系公司实际控制人。

本次发行的股票由公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特全额认购，本次发行完成后，梁大钟先生仍为公司的控股股东，梁大钟、白瑛、梁华特为公司实际控制人，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特。

七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次股票发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需履行以下核准程序：

(一)本次向特定对象发行股票方案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)本次向特定对象发行股票方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

(三)在获得中国证监会同意注册的批复文件后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

第二节 发行对象的基本情况

一、基本信息

本次向特定对象发行股票的发行对象为梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生。

梁大钟先生基本情况如下：

梁大钟，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号:330602195902055****。1959年出生，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业。1984年8月至1990年3月任华越微电子有限公司工程师；1990年3月至1997年11月在深圳电子市场从事业务工作；1997年11月至2008年11月任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001年4月至2012年12月任天光集成执行董事、总经理；2006年11月至2013年6月任气派有限执行董事、总经理；2013年6月至今任公司董事长、总经理；2013年5月至2022年9月任广东气派执行董事、总经理；2022年9月至2024年7月任广东气派执行董事；2022年4月至今任东莞市志源集成电路科技发展有限公司董事；2022年6月至2024年5月任气派芯竞执行董事、总经理；2024年5月至今任气派芯竞董事；2024年7月至今任广东气派执行董事、总经理；2025年1月至今任惠州气派执行董事、经理。

白瑛女士基本情况如下：

白瑛，女，中国国籍，无境外居留权，身份证号:330602196405298****。1964年生，高中。1983年9月至1992年5月就职于华越微电子有限公司；1992年6月至1997年11月在深圳电子市场从事业务工作；1997年11月至2008年11月任深圳市天光微电子有限公司副总经理，2001年4月至2012年12月任天光集成监事；2006年11月至2013年6月任气派有限监事；2013年6月至今任公司董事，2022年8月至今任气派科技(香港)有限公司董事。

梁华特先生基本情况如下：

梁华特，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号:440304199105244****。1991年生，本科，毕业于俄勒冈州立大学工商管理专业。2019年8月至2021年12月任上海柳客慧餐饮管理有限公司合伙人；2022年1月至2023年8月任中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司设备工程师；2024年2月至2025年7月在公司封装制造中心任职；2024年5月至今任气派芯竞董事；2025年7月至今任公司总经理助理。

二、最近五年任职经历及任职单位产权关系

截至本预案公告日，发行对象梁大钟、白瑛、梁华特近五年主要任职情况如下：

发行对象	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系	是否存续
梁大钟	气派科技股份有限公司	董事长、总经理	是，直接持股42.78%	是
	东莞市气派渠远股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	是，持有26.16%的出资份额	是
	广东气派科技有限公司	执行董事	是，间接持股42.78%	是
	东莞市志源集成电路科技发展有限公司	董事	是，间接持股4.28%	是
	气派芯竞科技有限公司	董事	是，间接持股17.65%	是
	惠州气派科技有限公司	执行董事、经理	是，间接持股29.95%	是
白瑛	气派科技股份有限公司	董事	是，直接持股10.09%	是
	气派科技(香港)有限公司	董事	是，间接持有10.09%	是
梁华特	气派芯竞科技有限公司	董事	是，直接持股38.75%	是
	中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	设备工程师	否	是

三、发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本预案公告日，梁华特先生无其他控制的企业，除上市公司及其子公司外，白瑛女士无其他控制的企业，梁大钟先生所控制的核心企业和关联企业业务情况如下：

企业名称	注册资本(万元)	持有份额比例	经营范围
东莞市气派渠远股权投资合伙企业(有限合伙)	17,335	26.16%	股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次发行对象最近五年受处罚情况

梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生最近5年未受到行政处罚、刑事处罚、监管措施，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况

本次发行完成前，梁大钟先生系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士系公司实际控制人；本次发行完成后，梁大钟先生仍系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士仍系公司实际控制人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士的儿子，梁华特将成为公司实际控制人之一。梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生为本公司的关联方，梁大钟、白瑛、梁华特拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

公司审计委员会发表了同意的书面审核意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。股东会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联股东应进行回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司股本总额为10,687.98万股，梁大钟直接持有公司4,579.00万股股份，通过气派渠远间接控制公司1.50万股，合计控制公司股份总数的42.86%，系公司的控股股东；白瑛直接持有公司1,080.00万股，占公司股份总数的10.11%，梁大钟、白瑛夫妇合计控制公司股份总数的52.96%，系公司实际控制人。

本次发行的股票由公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特全额认购，本次发行完成后，梁大钟先生仍为公司的控股股东，梁大钟、白瑛、梁华特为公司实际控制人，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特。

七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次股票发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需履行以下核准程序：

(一)本次向特定对象发行股票方案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)本次向特定对象发行股票方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

(三)在获得中国证监会同意注册的批复文件后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况

(一)本次发行对公司业务及资产的影响

公司专注于从事半导体的封装、测试业务，MEMS、FC、5G氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、QIPAI、DIP、PDFN等多个系列，共计超过300种封装形式。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行将有助于增强公司的资本实力，充实营运资金，优化财务结构，有利于公司长远经营发展，满足业务持续发展资金需求。本次发行不涉及对公司现有业务及资产的整合，公司主营业务结构不会发生重大变化，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

(二)本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，本次发行完成后，公司章程的其他条款不存在因本次发行而受到影响的情形。

(三)本次发行对股东结构的影响

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过15,900.00万元，同时发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，实际控制人将由梁大钟、白瑛夫妇变更为梁大钟、白瑛和梁华特。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

(四)本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不涉及对公司高级管理人员结构的调整。截至本预案公告日，公司无对高管人员结构进行重大调整的计划。若公司未来拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

(五)本次发行对业务结构的影响

本次发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，本次发行后公司业务不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，资产结构将得到优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降低公司的财务风险，提升公司盈利能力，增强公司的综合竞争力。

(二)本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将相应增加，公司净资产收益率和每股收益存在短期内被摊薄的风险。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，详见本预案"第八节 本次发行股票摊薄即期回报分析"。

(三)本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位使得公司筹资活动现金流入大幅增加。未来随着公司资本实力进一步提升，公司主营业务的盈利能力将得以加强，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行的股票由公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特全额认购，本次发行完成后，梁大钟先生仍为公司的控股股东，梁大钟、白瑛、梁华特为公司实际控制人，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特。

本次发行完成后，公司的控股股东未发生变化，梁华特成为公司实际控制人之一，不会对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系产生重大变化，也不会因本次发行形成同业竞争。公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不会因此而受影响。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，将进一步降低公司资产负债率，提升偿债能力，改善财务状况和资产结构，有利于增强公司抗风险能力，实现长期可持续发展，符合公司全体股东的利益。公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第六节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、市场和行业风险

(一)宏观经济及下游相关行业需求变化的风险

公司主营业务为半导体封装测试，半导体行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。半导体行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球半导体产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

同时，公司下游消费电子行业产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期短于其他传统行业。如果公司未来不能快速响应终端市场的需求变化，或公司主要客户对应产品在终端市场竞争中处于不利地位，公司现有市场规模将难以保持甚至出现萎缩，进而对公司经营